

株主通信 | 春 | 号 |

2017年9月期 第1四半期業績のご報告 (2016年10月1日～2016年12月31日)

本株主通信は2016年9月末時点での株主の皆様にお送りいたしますことをご了承ください。

株式会社 **日本マイクロニクス**
証券コード：6871

株主・投資家の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

当第1四半期におきまして、半導体市場では、DRAMの価格が上昇に転じたことや、三次元NANDの本格量産に向けた投資が進み、製造装置や電子部品等のメーカーを含む市場は総じて堅調に推移しました。FPD市場でも、供給過剰による生産調整において進捗が見られ、一部パネルに不足感も出始めたことから価格も上昇に転じ、底堅く推移しました。

このような状況の下、当社グループは、引き続き中期経営計画『Challenge17』を推進し、新たな成長のステップを確実に踏むための地盤づくりを行ってまいりました。

この結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高6,845百万円（前年同期比6.1%減）、営業利益214百万円（前年同期比71.2%減）、経常利益273百万円（前年同期比65.9%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益133百万円（前年同期比69.6%減）となりました。

株主の皆様におかれましては、引き続き、ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

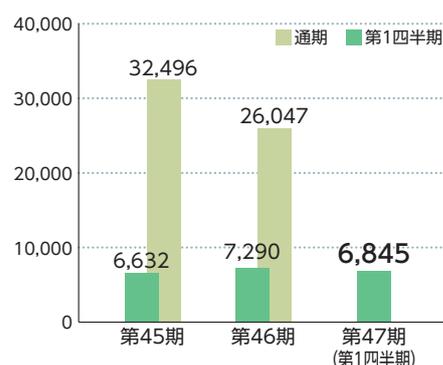
2017年3月

代表取締役社長

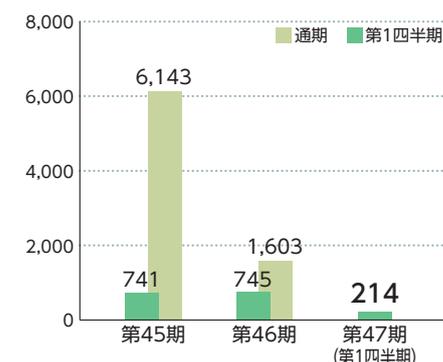
長谷川 正義



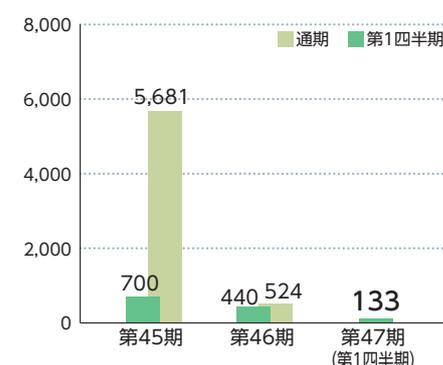
❖ 売上高 (百万円)



❖ 営業利益 (百万円)



❖ 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (百万円)



半導体 関連製品

様々なニーズに適した半導体テスト・ソリューション

当社は半導体の高機能化、多様化に伴い検査ニーズが高度化する中、信頼性の高い電子計測技術と製品で、半導体の生産性及び品質の向上を支えています。

当社が手がける半導体関連製品は、ウェーハ検査工程で使用する「プローブカード」、「ウェーハプローバ」、「テスト」と、最終検査工程で使用する「テストソケット」です。中でもプローブカードは当社売上の大半を占める主力製品で、その品質と性能が高く評価されています。また、プローブカードメーカーであると共に半導体検査装置の開発・製造も行っており、テスト・ソリューションとして提案できる点が強みです。

TE事業

16.9%

半導体検査装置 (12.6%)

- 半導体試験装置 (テスト)
- ウェーハプローバ 等

FPD関連製品 (4.3%)

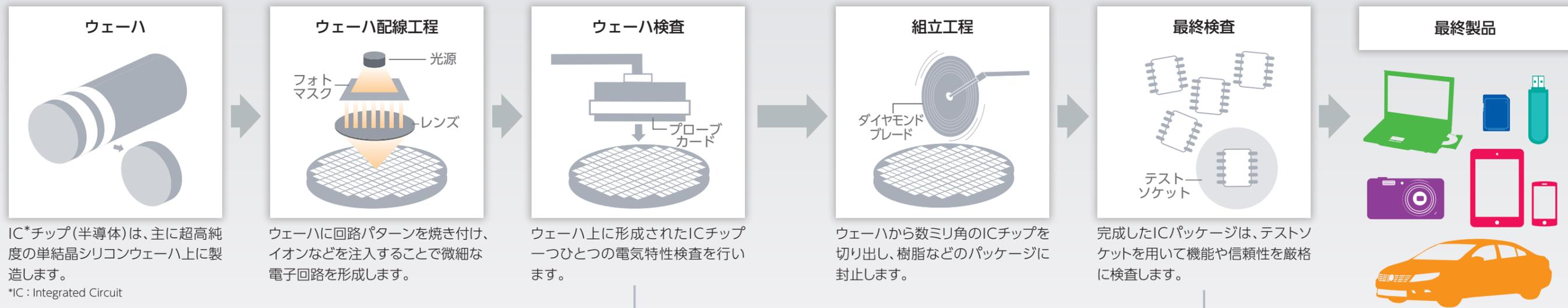


プローブカード 事業

83.1%

- プローブカード
- テストソケット

半導体製造プロセス



当社製品例



プローブカード
ウェーハプローバに装着し、プローブカードに立てられた針先を通じてテストの電気信号をウェーハ上のICチップへ伝えます。



ウェーハプローバ
ウェーハを搬送し、プローブカードとウェーハが正確にコンタクトできるような位置決めを行う装置。

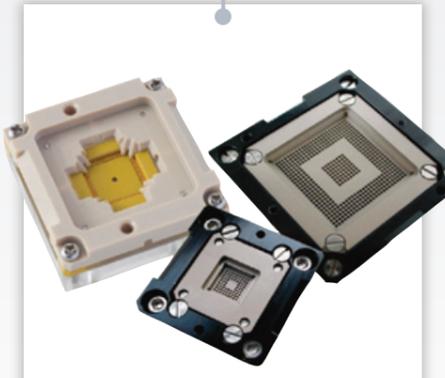


■ウェーハ検査イメージ図
プローブカード
ウェーハ
電気信号

半導体試験装置 (テスト)
ウェーハ検査とは
ウェーハプローバ
テスト、ウェーハプローバ、プローブカードを用いて行う、ウェーハの電気的特性検査。



半導体試験装置 (テスト)
デバイスの良否判定を行う装置。



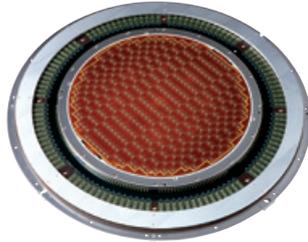
テストソケット
プローブカードと同様、テストソケットの接触子を通じて、テストの電気信号をパッケージされたICに伝えます。

営業の概況

プローブカード事業

プローブカードは、DRAM市況の回復やNAND需要の増加によりメモリ向けアドバンスドプローブカードの需要は徐々に回復しておりますが、モバイル端末向けプローブカードが高需要であった前年同期より減収となりました。利益面においても、売上高の減少、及び製品構成が変化した結果、前年同期より減益となりました。

この結果、売上高は5,687百万円(前年同期比11.3%減)、セグメント利益は567百万円(前年同期比55.5%減)となりました。



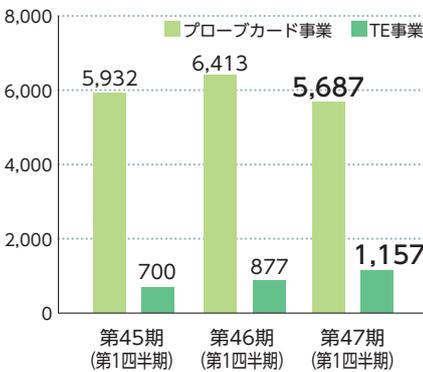
TE事業

半導体検査装置は、前年度に引き続き高需要となり、堅調に推移しました。LCD関連では、検査装置は低調でしたが、プローブユニットについては底堅く推移しました。利益面においては、売上高増加の影響もあり、増益となりました。

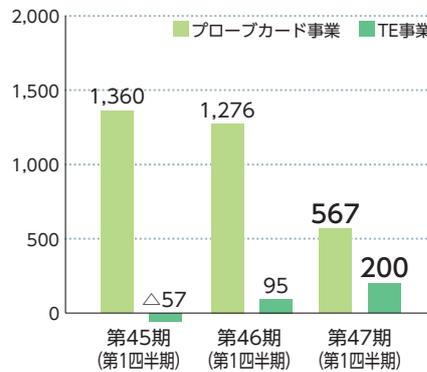
この結果、売上高は1,157百万円(前年同期比32.0%増)、セグメント利益は、200百万円(前年同期比109.9%増)となりました。



◆ セグメント別売上高(百万円)



◆ セグメント別営業損益(百万円)



◆ 地域別売上高構成比(百万円)



日本	1,987 (29.0%)
韓国	2,195 (32.1%)
台湾	1,641 (24.0%)
その他アジア	465 (6.8%)
欧州・米国	557 (8.1%)

通期業績予想

売上高

30,000 百万円

営業利益

2,000 百万円

親会社株主に帰属する当期純利益

1,500 百万円

1株当たり配当金

10 円

TOPICS 「SEMICON Japan 2016」に出展しました。

2016年12月14日(水)～16日(金)に東京ビッグサイトで開催された「SEMICON Japan 2016」に出展し、プローブカードをはじめ、半導体試験装置(テスタ)、ウェーハプローバ、テストソケット等を展示いたしました。

SEMICON Japanは半導体業界では国内最大規模の展示会で、今回で記念すべき40回目を迎えました。当社は第1回より出展しており、他13社と共に連続出展の表彰を受けました。

本展示会は、当社及び製品の認知度向上に寄与するだけでなく、お客様や学生の方、仕入れ先等、多くの方々とのコミュニケーションを図るための貴重な機会となっています。今後もこうした機会を新たなビジネス創造に向けた積極的な情報の発信・収集、ネットワーキングの場として活用し、日本の半導体業界の発展に貢献していきます。



株式事務についてのご案内

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社

連絡先 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
☎ 0120-232-711 (フリーダイヤル)

株式会社 **日本マイクロニクス**
MICRONICS JAPAN CO., LTD.

本社 〒180-8508 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-6-8
HPアドレス <http://www.mjc.co.jp/>